

○高熱伝導率タイプ基板材料

ML シリーズ

ML シリーズはセラミックフィラー配合の高熱伝導性エポキシ樹脂基板材料です。ハロゲンフリー及び難燃性にも対応しています。熱対策が必要な用途やプリプレグのラインナップもあるため多層板構造でも効果的な放熱が可能です。ML シリーズは片面アルミプレート付き基板でも提供しています。

誘電率 @ 1MHz	誘電正接 @ 1MHz	熱伝導率 W/m/K	ガラス転移温度 °C	難燃性
5.3	0.011	XY : 3.5 / Z : 1.6	160	94V-0

参考用途

- ・高輝度 LED 基板
- ・AC/DC, DC/DC パワーコンバーター
- ・車載用基板用途

COOLSPAN TECA

熱硬化性エポキシ樹脂ベースに銀を配合した導電性タイプの高熱伝導性接着フィルムです。厚い金属プレート、ヒートシンクコインや RF モジュールのハウジングを回路基板に貼り付けるような用途に最適です。液状ハンダやディスペンサータイプの接着材で問題となるボイドやフロー性を解決します。

熱伝導率 W/m/K	ガラス転移温度 °C	熱膨張係数 Z 方向 ppm/°C
6.0	79	<Tg : 45 / >Tg : 70

参考用途

- ・厚い金属プレート付き基板の代替
- ・金属板加工後の接着剤
- ・パワーアンプ用ヒートシンクコインの接着剤
- ・RF 回路基板モジュールの組立て用途